

<<电子及通信专业毕业设计宝典>>

图书基本信息

书名：<<电子及通信专业毕业设计宝典>>

13位ISBN编号：9787560620022

10位ISBN编号：7560620027

出版时间：2008-3

出版时间：西安电科大

作者：那彦 编

页数：236

字数：359000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子及通信专业毕业设计宝典>>

内容概要

本书包括毕业设计实施及其管理方法、毕业设计常用工具介绍、毕业设计实际案例解析三个部分内容。

第一部分介绍了毕业设计实施及其管理办法；第二部分主要介绍了MATLAB通信系统类工具及信号处理类工具、EDA软件、DSP、ADSP的软件开发工具VisualDSP++、LabVIEW、PSpice软件、计算机控制相关基本知识、硬件设计部分内容；第三部分对8个毕业设计实际案例进行了详细解析。

本书可作为高等院校通信工程、电子工程、计算机工程和控制工程专业本科毕业设计的辅助教材，也可作为学生工程实践的参考书。

书籍目录

第一部分 毕业设计实施及其管理方法 第1章 毕业设计的目的和作用 1.1 毕业设计的目的 1.2 毕业设计的作用 第2章 毕业设计的组织与管理 2.1 毕业设计的组织 2.2 毕业设计全过程各阶段任务 2.3 毕业设计全过程质量管理 第3章 毕业设计的选题 3.1 毕业设计的选题原则 3.2 毕业设计选题工作的组织 第4章 毕业设计的课题类型 4.1 理论研究型毕业设计 4.2 应用型毕业设计 4.2.1 软件开发型毕业设计 4.2.2 硬件开发型毕业设计 4.3 工程设计型毕业设计 第5章 毕业设计(论文)评阅、答辩及综合成绩评定 5.1 毕业设计(论文)评阅 5.2 毕业设计(论文)综合成绩评定原则 5.3 毕业设计(论文)答辩的组织和过程 第6章 毕业设计指导教师职责和要求 6.1 毕业设计对指导教师的基本要求 6.2 指导教师的职责 第7章 毕业设计的过程 7.1 毕业设计对学生的总体要求 7.2 毕业设计的总体步骤 7.3 不同类型题目的毕业设计过程要求 第8章 毕业设计(论文)的基本规范 8.1 毕业设计(论文)的撰写规范 8.2 关于违反学术规范的处理 附录第二部分 毕业设计常用工具介绍 第1章 MATLAB通信系统类工具 1.1 概述 1.2 通信工具箱——使用M语言 1.2.1 通信工具箱简介 1.2.2 实例介绍 1.2.3 小结 1.3 通信模块集——使用Simulink 1.3.1 通信模块集简介 1.3.2 实例介绍 1.3.3 小结 第2章 MATLAB信号处理类工具 2.1 概述 2.2 信号处理工具箱 第3章 EDA软件 3.1 引言 3.2 关于专用集成电路(ASIC)与VHDL 3.2.1 ASIC的设计流程 3.2.2 VHDL的主要优点 3.2.3 VHDL源程序的基本结构 3.2.4 VHDL设计的仿真 3.2.5 VHDL设计的综合 3.2.6 经典的自下至上系统设计方法(Bottom to Top) 3.2.7 现代的自顶向下系统设计方法(Top to Down) 3.3 现场可编程门阵列(FPGA)和复杂可编程逻辑器件(CPLD) 3.3.1 引言 3.3.2 CPLD器件简介 3.3.3 FPGA器件简介 3.3.4 CPLD/FPGA编程与配置 3.3.5 器件的选择 3.3.6 Altera公司的Max+plus 开发系统 3.4 EDA工程设计方法与数字通信系统建模 第4章 DSP概述 4.1 DSP芯片的发展 4.2 DSP芯片的结构特点 4.3 DSP芯片的应用 4.4 DSP芯片的分类 4.5 DSP芯片的选择 第5章 ADSP的软件开发工具Visual DSP++ 5.1 DSP的软件开发流程 5.2 开发工具Visual DSP++概述 5.3 集成开发环境 5.4 选择合适的调试平台 5.5 Dcbugger工具 5.6 编写链接描述文件 第6章 LabVIEW介绍 6.1 虚拟仪器简介 6.2 LabVIEW及其特点 6.3 LabVIEW的开发平台 6.4 LabVIEW的操作界面 第7章 PSpice软件介绍 7.1 电子线路模拟(PSpice)软件简介 7.2 PSpice软件工作平台 7.3 PSpice软件的电路特性分析功能 7.4 PSpice软件实现电路模拟的步骤 第8章 计算机控制相关基本知识 8.1 传感器简介 8.1.1 传感器的定义 8.1.2 传感器的组成 8.1.3 传感器的分类 8.1.4 传感器的特性 8.1.5 传感器选用原则 8.2 嵌入式模块 8.2.1 编程平台 8.2.2 常用编程语言 第9章 硬件设计部分内容 9.1 常用元器件 9.1.1 电阻器 9.1.2 电位器 9.1.3 电容器 9.1.4 电感器 9.1.5 变压器 9.1.6 继电器 9.1.7 传感器 9.1.8 二极管、三极管和可控硅 9.1.9 半导体集成电路 9.1.10 单片机类别简介 9.2 常用EDA软件及开发工具的介绍 9.2.1 印刷电路板设计工具简介 9.2.2 CPLD/FPGA开发软件简介 9.2.3 单片机开发常用软件简介 9.3 常用硬件电路设计指南 第三部分 毕业设计实际案例解析 第1章 基于ASIC Z87200芯片设计一种直接序列扩频数传收发信机实用方案 1.1 案例点评 1.2 案例 1.2.1 设计任务 1.2.2 设计意义 1.2.3 设计方案及实现 第2章 GSM数字蜂窝移动通信系统多基站模拟工程设计 2.1 案例点评 2.2 案例 2.2.1 设计任务 2.2.2 设计意义 2.2.3 设计方案及实现 第3章 非线性PID控制DC/DC转换器研究 3.1 案例点评 3.2 案例 3.2.1 设计任务 3.2.2 设计意义 3.2.3 设计方案及实现 第4章 基于CAN总线的ABS试验台多路测速模块设计与实现 4.1 案例点评 4.2 案例 4.2.1 设计任务 4.2.2 设计意义 4.2.3 设计方案及实现 第5章 基于单片机的温度测控系统的设计与实现 5.1 案例点评 5.2 案例 5.2.1 设计任务 5.2.2 设计意义 5.2.3 设计方案及实现 第6章 基于短消息平台的邮件提示系统 6.1 案例点评 6.2 案例 6.2.1 设计任务 6.2.2 设计意义 6.2.3 设计方案及实现 第7章 基于动态视频字符叠加的数字测径仪设计 7.1 案例点评 7.2 案例 7.2.1 设计任务 7.2.2 设计意义 7.2.3 设计方案及实现 第8章 远程图像监控系统的ARM核心单元设计 8.1 案例点评 8.2 案例 8.2.1 设计任务 8.2.2 设计意义 8.2.3 设计方案及实现

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>